

ПАНЕЛЬКИ ДЛЯ (ПОД) МИКРОСХЕМЫ

Панелька	SCS-6 панелька для микросхем	80шт/лин
Панелька	SCS-8 панелька для микросхем	60шт/лин
Панелька	SCS-14 панелька для микросхем	34шт/лин
Панелька	SCS-16 панелька для микросхем	30шт/лин
Панелька	SCS-18 панелька для микросхем	26шт/лин
Панелька	SCS-20 панелька для микросхем	24шт/лин
Панелька	SCS-22 панелька для микросхем	
Панелька	SCL-24 панелька для микросхем,широкая	20шт/лин
Панелька	SCS-24 панелька для микросхем,узкая	20шт/лин
Панелька	SCL-28 панелька для микросхем,широкая	17шт/лин
Панелька	SCS-28 панелька для микросхем,узкая	17шт/лин
Панелька	SCL-32 панелька для микросхем,широкая	15шт/лин
Панелька	SCL-40 панелька для микросхем,широкая	12шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-6 (TRS-6) панелька цанговая	80шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-8 (TRS-8) панелька цанговая	60шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-14 (TRS-14) панелька цанговая	34шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-16 (TRS-16) панелька цанговая	30шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-18 (TRS-18) панелька цанговая	26шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-20 (TRS-20) панелька цанговая	24шт/лин
Панелька цанговая	SCLM-24 (TRL-24) панелька цанговая,широкая	20шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-24 (TRS-24) панелька цанговая,узкая	20шт/лин
Панелька цанговая	SCLM-28 (TRL-28) панелька цанговая,широкая	17шт/лин
Панелька цанговая	SCSM-28 (TRS-28) панелька цанговая,узкая	17шт/лин
Панелька цанговая	SCLM-32 (TRL-32) панелька цанговая,широкая	15шт/лин
Панелька цанговая	SCLM-40 (TRL-40) панелька цанговая,широкая	12шт/лин
Панелька цанговая	PSLM-1x40 штыревой соединитель цанговый	
Панелька цанговая	SCSL-05 панелька , цанговая, 1 ряд,	
Панелька цанговая	SCSL-10 панелька , цанговая, 1 ряд,	
Панелька цанговая	SCSL-20 панелька , цанговая, 1 ряд,	
Панелька цанговая	SCSL-30 панелька , цанговая, 1 ряд,	
Панелька	ICSS-64 (ICSL-64) панелька для микросхем,шаг 1,778	
Панелька	PLCC-20 панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-28 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-28 SMD панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-32 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-32 SMD панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-44 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-44 SMD панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-52 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-52 SMD панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-68 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-68 SMD панелька для микросхем	
Панелька	PLCC-84 панелька для микросхем	
Панелька	PLSM-84 SMD панелька для микросхем	

Панельки

pc8
 pc18-1
 pc18-1
 pc18-1
 pc24
 pc24
 pc24-7
 pc24-7
 pc24-7
 pc24-8
 pc24-н
 pc28-80
 pc40-8
 pc40-8-0
 pc40-8-0
 pc48-11
 pc1-16-1
 pc1-16-1
 pc1-20-1
 pc1-20-1
 pc1-22-3
 pc1-40-7
 ук1-1
 ук3-1
 ук3-1
 ук3-1
 ук4-1
 ук9-1
 ук9-1
 Панельки импортные

DIP6-S-M
 DIP8-S
 DIP8-S WELLS
 DIP8-S-M
 DIP10-S PLUG-G
 DIP14-S
 DIP14-S WELLS
 DIP14-S PLUG-G
 DIP14-S-M
 DIP16-S
 DIP16-S WELLS
 DIP16-S-M
 DIP18-S
 DIP18-S WELLS
 DIP18-S-M
 DIP18-S-M-G
 DIP20-S
 DIP20-S WELLS
 DIP20-S PLUG-G
 DIP20-S-M
 DIP22-S
 DIP22-S WELLS
 DIP22-S-M
 DIP24 ZIF ARIES
 DIP24 ZIF-GARIES
 DIP24-S
 DIP24-S WELLS

DIP-панели цанговые TRS (SCSM) и TRL (SCLM)

Цанговые панели с шагом 2,54мм

ICSS-42, ICSS-52, ICSS-56, ICSS-64

ICSS(ICSL) - панели для DIP микросхем с мелким шагом 1,7778мм

SCL-24, SCL28, SCL-32, SCL-40

DIP панели для микросхем широкие с шагом 2,54мм

SCS-6,SCS-8,SCS-14,SCS-16,SCS-18,SCS-20,SCS-24,SCS-28

DIP панели для микросхем узкие с шагом 2,54мм

SOIC16-DIP16 переходник

Переходник для микросхем SOIC-16 / DIP-16

SOIC28-DIP28 переходник

Переходник для микросхем SOIC-28 / DIP-28

ZIF-11x11 (6311-90)

Панель с нулевым усилением матричная 11x11 контактов

ZIF-QFP-48 (248-5085)

Панель с нулевым усилением QFP-48

ZIF-панели CONNFLY (ZIF-14, ZIF-16, ZIF-18, ZIF-20)

Панели с нулевым усилением для программаторов и тестирования (DIP-14, DIP-16, DIP-18, DIP-20)

ZIF-панели CONNFLY (ZIF-24, ZIF-28, ZIF-40, ZIF-48)

Панели с нулевым усилением для программаторов и тестирования (DIP-24, DIP-28, DIP-40, DIP-48)

ZIF-панели TEXTDOL (ZIF-24W, ZIF-28W, ZIF-40W)

Панели с нулевым усилением для программаторов и тестирования (DIP-24, DIP-28, DIP-40)

ZIF-панель ARIES ZIF-32

Панель с нулевым усилением для программаторов и тестирования (DIP-32)

ZIF-переходник SOP-8/DIP-8

Переходник SOP-8/DIP-8 с ZIF-панелью.

DIP24-S-M
DIP24-W
DIP24-W-M
DIP28 ZIF ARIES
DIP28-S
DIP28-S WELLS
DIP28-S-M
DIP28-W
DIP28-W WELLS
DIP28-W PLUG-G
DIP28-W-M
DIP28-W-M-G
DIP32-S WELLS
DIP32-W
DIP32-W WELLS
DIP32-W-M
DIP40 ZIF ARIES
DIP40-S PLUG-G
DIP40-W
DIP40-W WELLS
DIP40-W-M
DIP42 ZIF ARIES
DIP42 ZIF-GARIES
DIP42-W
DIP48-W
DIP48-W-M
DIPH28 шаг 1.778
DIPH30 шаг 1.778
DIPH32 шаг 1.778
DIPH40 шаг 1.778
DIPH42 шаг 1.778
DIPH48 шаг 1.778
DIPH52 шаг 1.778
DIPH56 шаг 1.778
DIPH64 шаг 1.778
FPQ-208-0.5-06 ENPLAS
FPQ-240-0.5-03 ENPLAS
FPQ-352-0.5-01 ENPLAS
IPGA32535x35 ZIF WELLS
LCC100
PGA18015x15 ZIF WELLS
PLCC20
PLCC20 SMD
PLCC20 ZIF WELLS
PLCC28
PLCC28 SMD
PLCC28 ZIF WELLS
PLCC32
PLCC32 SMD
PLCC32 ZIF WELLS
PLCC32 ZIF-GARIES
PLCC44
PLCC44 SMD
PLCC44 ZIF WELLS
PLCC44-G
PLCC52
PLCC52 ZIF WELLS
PLCC68
PLCC68G
PLCC68 SMD
PLCC68 ZIF WELLS

PLCC68 ZIF-GARIES
PLCC84
PLCC84 SMD
PLCC84 ZIF WELLS
PLCC84 ZIF-GARIES
SOICZIFуниверс.ARIES
SOJ20 ZIF WELLS
SOJ32 ZIF WELLS
SOP8 ZIF WELLS
SOP8S ZIF WELLS
SOP8W ZIF WELLS
SOP14 ZIF WELLS
SOP14S ZIF WELLS
SOP16W ZIF WELLS
SOP18 ZIF WELLS
SOP24 ZIF WELLS
SOP28 ZIF WELLS
SOP28S ZIF WELLS
SOP28W ZIF WELLS
SOP32 ZIF WELLS
SOP40 ZIF WELLS
SOP44 ZIF WELLS
SSOP8 ZIF WELLS
SSOP16 ZIF WELLS
SSOP20 ZIF WELLS
SSOP24 ZIF WELLS
SSOP24S ZIF WELLS
SSOP28 ZIF WELLS
SSOP32 ZIF WELLS
SSOP44 ZIF WELLS
SSOP48 ZIF WELLS
TQFP327x7ZIF-G WELLS
TQFP4410x10 ZIF WELLS
TQFP4410x10ZIF-G WELLS
TQFP4410x10WZIF-G WELLS
TQFP487x7 ZIF WELLS
TQFP5210x10 ZIF WELLS
TQFP6410x10ZIF-G WELLS
TQFP6414x14L ZIF WELLS
TQFP6414x14SW ZIF WELLS
TQFP6414x14WZIF-G WELLS
TQFP8014x14 ZIF WELLS
TQFP10014x14 ZIF WELLS
TQFP10014x14ZIF-G WELLS
TQFP10014x20 ZIF WELLS
TQFP11220x20 ZIF WELLS
TQFP12814x20 ZIF WELLS
TQFP14420x20 ZIF WELLS
TQFP14428x28W ZIF WELLS
TQFP16028x28S ZIF WELLS
TQFP20828x28 ZIF WELLS
TQFP20828x28SZIF-G WELLS
TSOP-128 ZIF WELLS
TSOP-132 ZIF WELLS
TSOP-132S ZIF WELLS
TSOP-140 ZIF WELLS
TSOP-140S ZIF WELLS
TSOP-148 ZIF WELLS
TSOP-156 ZIF WELLS
TSOP-232 ZIF WELLS
TSOP-244 ZIF WELLS

TSOP-250 ZIF WELLS TSOP-254 ZIF WELLS TSSOP16 ZIF WELLS

Панельки под (для) микросхемы

Панели под микросхемы

Панель представляет собой гнездо, в которое устанавливается микросхема. Применение панелей облегчает монтаж и демонтаж микросхем и обеспечивает надежный контакт микросхемы с печатной платой.

Существуют следующие типы панелей:

DIP (dual in-line package)

Широко распространенная и самая дешевая серия панелей для микросхем в корпусе DIP. Панели DIP со штыревыми выводами могут иметь от 6 до 48 контактов, расположенных по обе стороны. Они могут быть узкими (ширина 7,62 мм) (SCS) с количеством контактов от 6 до 32 или широкими (ширина 15,24 мм) (SCL) с количеством контактов от 24 до 48.

Выпускаются панели (SCS, SCL) с пружинными контактами, имеющие шаг 2,54 мм и 1,78 мм (ICSS). Панели (ICSS) могут быть также узкими и широкими и иметь от 6 до 64 контактов, расположенных в 2 ряда по обе стороны.

Производятся панели DIP с цанговыми штыревыми контактами с шагом 2,54 мм: узкие (SCSM) с количеством контактов от 6 до 28 или широкие от 18 до 48 (SCLM). Цанговые панели лучше контактируют с выводами микросхем, нежели чем пружинные, к сожалению, они в несколько раз дороже.

Также существует серия панелей DIP с цанговыми планарными контактами (SCSP), которые могут применяться для поверхностного монтажа.

Помимо 2-х рядных цанговых панелей (SCSM), существуют однорядные цанговые панели (SCSL) с количеством контактов от 5 до 40 и шагом 2,54 мм.

DIP ZIF (Zero Insertion Force- с нулевым усилием вставки)

Панели с нулевым усилием контактов (SCZP) предназначены для легкой установки в них микросхемы при высокой надежности контактов.

Гнезда панели имеют замок, открыв который можно установить или вытащить микросхему без приложения усилия к ее выводам.

Панели (SCZP) производят на 24, 28, 32, 40 и 48 контактов.

Применяются в основном в программаторах

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

Панели этой серии используются для микросхем в корпусе типа PLCC и обеспечивают надежный контакт микросхемы с печатной платой. Панели выпускаются со штыревыми выводами (PLCC) на 20, 28, 32, 44, 52, 68 и 84 контакта или с плоскими выводами для поверхностного монтажа (PLSM) на такое же количество контактов.

В корпусе панелей могут быть направляющие выступы, предназначенные для того, чтобы при помощи специального инструмента можно было достать микросхему из панели, не повредив ее.

SOJ (Small outline J-lead)

Панели этой серии используются для микросхем в корпусе SOJ. Плоские контакты этой панели располагаются с шагом 1,27 мм имеют форму J, и поэтому эта панель предназначена только для поверхностного монтажа.

Панели могут быть узкие SOJS (ширина 13,87 мм) с количеством контактов от 24 до 32 или широкие SOJL (ширина 16,04 мм) с количеством контактов от 28 до 40.

PGA (Pin Grid Array)

Панели PGA представляют собой матрицу с цанговыми контактами.

Панели этой серии используются для микросхем в корпусе типа PGA, например, центрального процессора. Панели PGA с цанговыми контактами могут быть на 68, 84, 121, 132, 144, 168 и 169 контактов.

Также существуют панели PGA ZIF с нулевым усилием вставки и могут быть на 237 (YPFA-237) или на 238 (YPFA-238) контактов.

SIMM

Панели этой серии применялись в основном под модули памяти SIMM (Single In-Line Memory Module). Панели могут иметь 30, 60 (2x30), 72 или 144 контакта. В панели на 30 (SIMM-30N) и 60 (SIMM-60N) контактов модули памяти могут вставляться под углом 26 градусов.

Фиксаторы у панелей SIMM бывают металлические или пластмассовые.

DIMM

Панели этой серии применяются в основном для подключения модулей памяти DIMM (Dual-In-Line-Memory Module). Панели выпускаются со штыревыми выводами на 168 (DIMM-168), 184 (DIMM-184) контакта и на 168 контактов с плоскими выводами для поверхностного монтажа (DIMM-168). У панелей DIMM имеются специальные защелки для надежной фиксации модуля памяти в гнезде панели.

Экстракторы для микросхем и тест-клипсы.

Для тестирования микросхем, устанавливаемых в панели DIP, применяются специальные тест-клипсы. Тест-клипса (TC) представляет из себя прищепку, которая обхватывает микросхему с двух сторон. В верхней части тест-клипсы расположены выводы для присоединения кабеля. Кабель можно присоединить при помощи однорядных разъемов (BLS). Тест-клипсы выпускаются для панелей с количеством контактов от 8 до 64..

Для удаления из панелей микросхем необходимо, чтобы не повредить микросхему, использовать **специальный инструмент**.

для узких панелей DIP (SCS) –EXTR-2;
для широких панелей DIP (SCSL) – EXTR-1;
для любых панелей PLCC –SY-304.

Панельки под микросхемы, PLCC

PLCC

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово поверх никеля

Изолятор: PPS, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

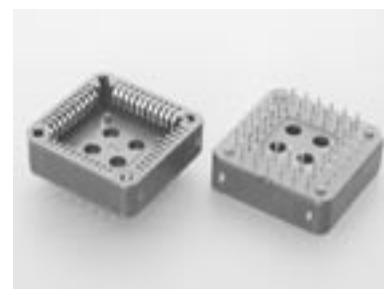
Предельное напряжение: 500В AC в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
при 500В DC

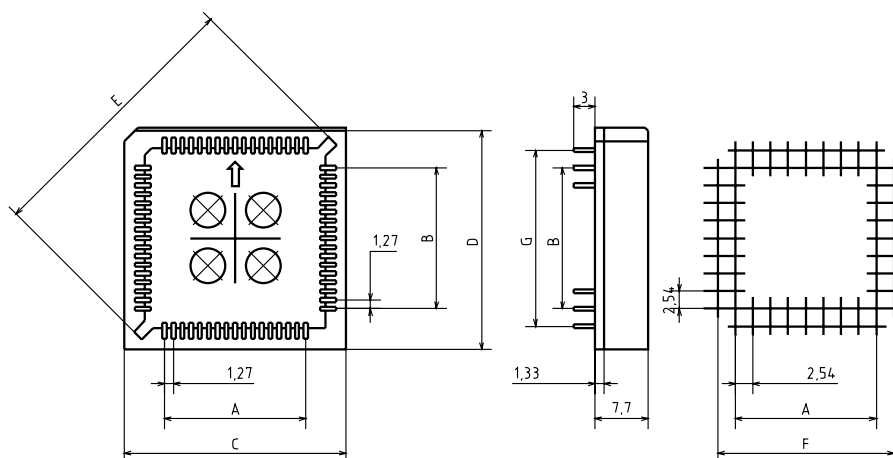
Сопротивление контактов: не более 3×10^{-2} Ом
при 100 мА DC

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



PLCC



PLCC-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	E	F	G
PLCC-20	5.08	5.08	15.50	15.50	18.00	10.50	10.50
PLCC-28	7.62	7.62	18.04	18.04	20.60	12.70	12.70
PLCC-32	7.62	10.16	18.04	20.60	23.60	12.70	15.20
PLCC-44	12.70	12.70	23.48	23.48	27.40	17.80	17.80
PLCC-52	15.24	15.24	25.88	25.88	31.50	20.50	20.50
PLCC-68	20.32	20.32	31.66	31.66	39.10	25.80	25.80
PLCC-84	25.40	25.40	37.70	37.70	45.70	30.50	30.50

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, PLCC планарные

PLSM

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово поверх никеля

Изолятор: PPS, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

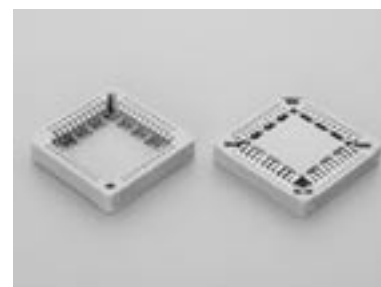
Предельное напряжение: 500 В AC в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
при 500 В DC

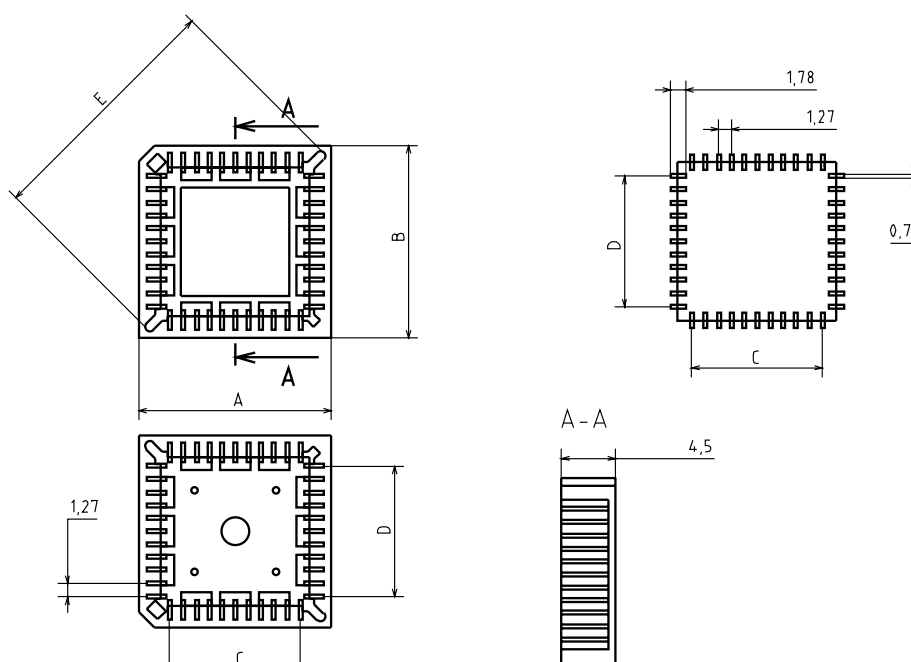
Сопротивление контактов: не более 3×10^{-2} Ом
при 100 мА DC

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



PLSM



PLSM-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	E
PLSM-20	15.50	15.50	5.08	5.08	17.21
PLSM-28	18.12	18.12	7.62	7.62	20.80
PLSM-32	18.12	20.66	7.62	10.16	22.59
PLSM-44	23.20	23.20	12.70	12.70	27.98
PLSM-52	25.74	25.74	15.24	15.24	31.57
PLSM-68	30.82	30.82	20.32	20.32	38.76
PLSM-84	35.90	35.90	25.40	25.40	45.94

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, DIP

SCS/L

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
при 500 В DC

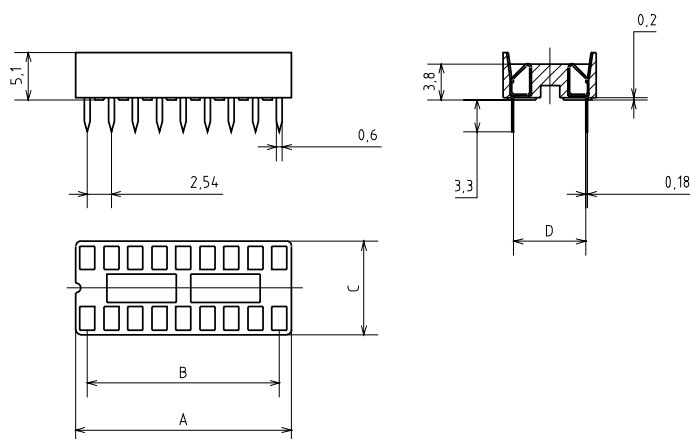
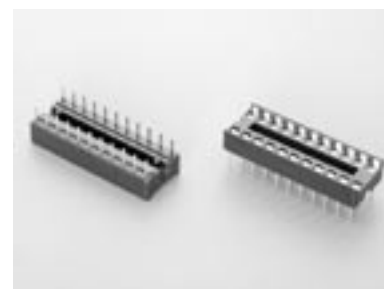
Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом

Усилие сочленения: не более 140 гр.

Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



SCS-xx, SCL-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	ПЕРЕГОРОДКА
SCS-6	7.62	5.08	9.96	7.62	–
SCS-8	10.16	7.62	9.96	7.62	–
SCS-14	17.78	15.24	9.96	7.62	–
SCS-16	20.32	17.78	9.96	7.62	–
SCS-18	22.86	20.32	9.96	7.62	–
SCS-20	25.40	22.86	9.96	7.62	–
SCS-22	27.94	25.40	9.96	7.62	–
SCS-24	30.48	27.94	9.96	7.62	1
SCS-28	35.56	33.02	9.96	7.62	1
SCS-32	40.64	38.10	9.96	7.62	1

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	ПЕРЕГОРОДКА
SCL-24	30.48	27.94	17.60	15.24	1
SCL-28	35.56	33.02	17.60	15.24	1
SCL-32	40.64	38.10	17.60	15.24	1
SCL-36	45.72	43.18	17.60	15.24	1
SCL-38	48.26	45.72	17.60	15.24	1
SCL-40	50.80	48.26	17.60	15.24	1
SCL-42	53.34	50.80	17.60	15.24	1
SCL-48	60.96	58.42	17.60	15.24	1

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, DIP цанговые

SCSM/LM

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение 1
мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

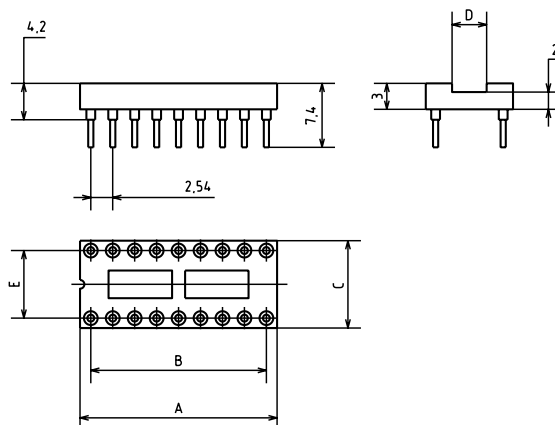
Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



SCSM-xx, SCLM-xx
xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	E	ПЕРЕГОРОДКА
SCSM-6	7.62	5.08	10.16	4.04	7.62	–
SCSM-8	10.16	7.62	10.16	4.04	7.62	–
SCSM-10	12.70	10.16	10.16	4.04	7.62	–
SCSM-14	17.78	15.24	10.16	4.04	7.62	–
SCSM-16	20.32	17.78	10.16	4.04	7.62	–
SCSM-18	22.86	20.32	10.16	4.04	7.62	1
SCSM-20	25.40	22.86	10.16	4.04	7.62	1
SCSM-22	27.94	25.40	10.16	4.04	7.62	1
SCSM-24	30.48	27.94	10.16	4.04	7.62	1
SCSM-28	35.56	33.02	10.16	4.04	7.62	1

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	E	ПЕРЕГОРОДКА
SCLM-18	22.86	20.26	17.78	11.72	15.24	1
SCLM-20	25.40	22.86	17.78	11.72	15.24	1
SCLM-24	30.48	27.94	17.78	11.72	15.24	1
SCLM-28	35.56	33.02	17.78	11.72	15.24	1
SCLM-32	40.64	38.10	17.78	11.72	15.24	1
SCLM-36	45.66	43.12	17.78	11.72	15.24	2
SCLM-40	50.80	48.26	17.78	11.72	15.24	2
SCLM-42	53.34	50.80	17.78	11.72	15.24	2
SCLM-48	60.98	58.44	17.78	11.72	15.24	2

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, DIP

ICSS

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом

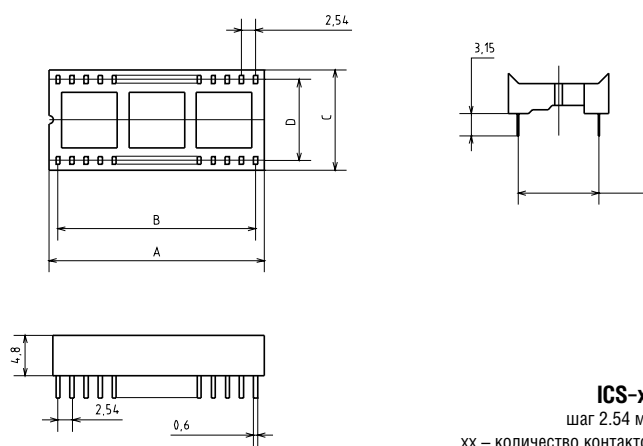
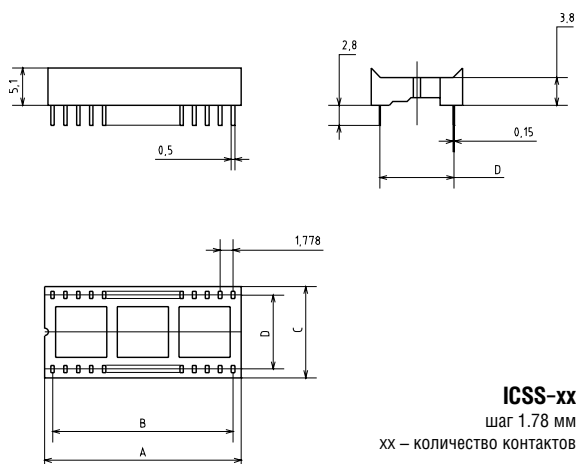
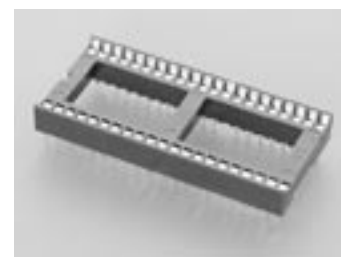
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D
ICSS-16	14.22	12.45	10.10	7.62
ICSS-20	17.76	16.00	10.10	7.62
ICSS-22	19.56	17.78	10.10	7.62
ICSS-24-1	21.34	19.56	12.65	10.16
ICSS-28	24.89	23.11	12.65	10.16
ICSS-30	26.67	24.89	12.65	10.16
ICSS-32	28.45	26.67	12.65	10.16
ICSS-40	35.56	33.78	17.70	15.24
ICSS-42	37.34	35.56	17.70	15.24
ICSS-48	42.67	40.89	17.70	15.24
ICSS-52	46.23	44.45	17.70	15.24
ICSS-54	48.01	46.23	17.70	15.24
ICSS-56	49.78	48.01	17.70	15.24
ICSS-60	53.34	51.56	17.70	15.24
ICSS-62	55.12	53.34	17.70	15.24
ICSS-64	56.90	55.12	21.55	19.05

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D
ICS-6	7.62	5.08	10.16	7.62
ICS-8	10.16	7.62	10.16	7.62
ICS-14	17.78	15.24	10.16	7.62
ICS-16	20.32	17.78	10.16	7.62
ICS-18	22.86	20.32	10.16	7.62
ICS-20	25.40	22.85	10.16	7.62
ICS-22	27.94	25.40	10.16	7.62
ICS-24	30.48	27.94	10.16	7.62
ICS-28	35.56	22.02	10.16	7.62
ICS-32	40.64	38.10	10.16	7.62
ICS-22-1	27.94	25.40	12.70	10.16
ICS-24-1	30.48	27.94	17.78	15.24
ICS-28-1	35.56	33.02	17.78	15.24
ICS-32-1	40.64	38.10	17.78	15.24
ICS-40	50.80	48.26	17.78	15.24
ICS-42	53.34	50.08	17.78	15.24
ICS-48	60.96	58.42	17.78	15.24
ICS-64	81.28	78.74	25.40	22.86

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, DIP с нулевым усилием

SCZP

Материал

Контакты: фосф. бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

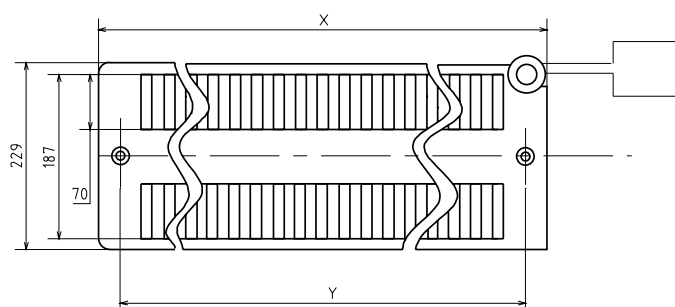
Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



SCZP



SCZP-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	кол-во контактов	X	Y
SCZP - 24	24	45.3	40.9
SCZP - 28	28	50.4	46.0
SCZP - 32	32	55.5	51.1
SCZP - 40	40	65.6	61.2
SCZP - 48	48	75.8	71.4

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, SIP однорядные, цанговые

SCSL

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

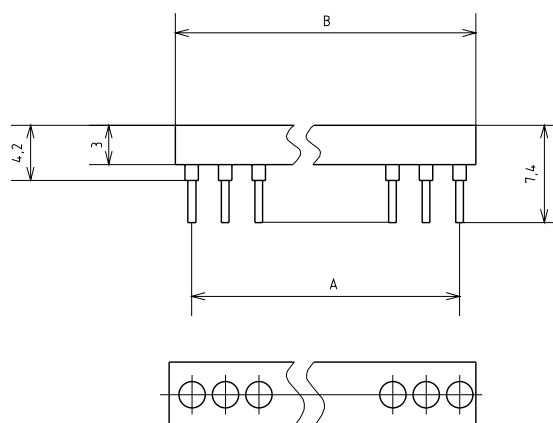
Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



SCSL-15



SCSL-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B
SCSL-5	10.2	12.7
SCSL-10	22.9	25.4
SCSL-15	35.6	38.1
SCSL-20	48.3	50.8
SCSL-25	61.0	63.5
SCSL-30	73.7	76.2
SCSL-32	78.7	81.3
SCSL-35	86.4	88.9
SCSL-40	99.1	101.6

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, SOJ (шаг 1.27мм)

SOJ

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

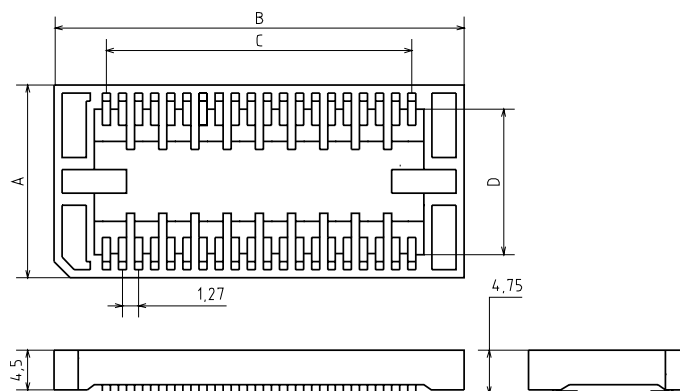
Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



SOJ



SOJS-xx, SOJL-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D
SOJS-24	13.87	23.26	13.97	8.05
SOJS-26	13.87	24.53	15.24	8.05
SOJS-28	13.87	25.80	16.51	8.05
SOJS-32	13.87	28.34	19.05	8.05
SOJL-28	16.04	25.78	16.51	10.73
SOJL-32	16.04	28.32	19.05	10.73
SOJL-40	16.04	33.40	24.13	10.73

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, PGA

PGA

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

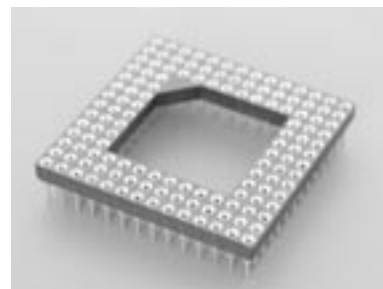
Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

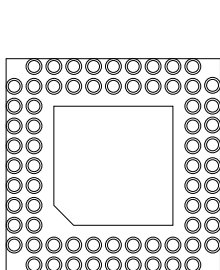
Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

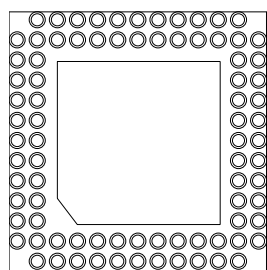
Допустимые температуры: от -55 до +105°C



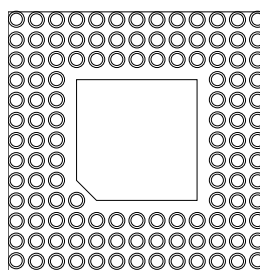
PGA



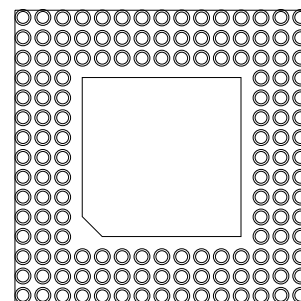
PGA-68



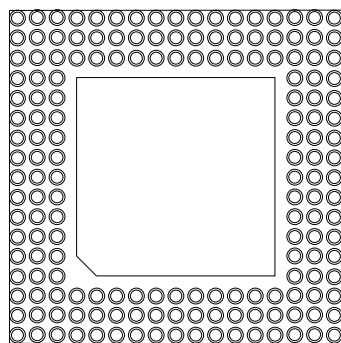
PGA-84N



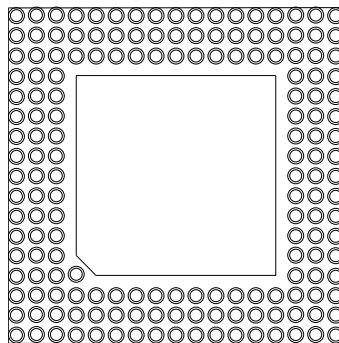
PGA-121N



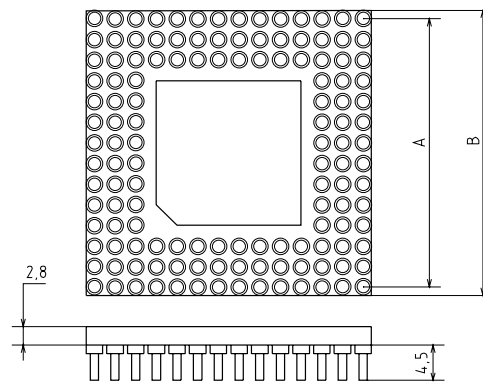
PGA-144



PGA-168



PGA-169

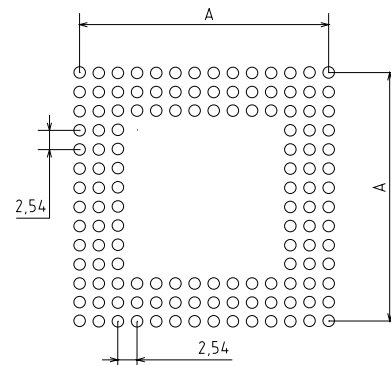


PGA-132

Модификации продукта*

Код продукта	кол-во контактов	A	B
PGA-68	68	25.40	28.10
PGA-84	84	30.48	32.92
PGA-121	121	30.48	32.92
PGA-132	132	33.02	35.46
PGA-144	144	35.56	38.00
PGA-168	168	40.64	43.25
PGA-169	169	40.64	43.25

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах



PGA-PCB

разметка платы

Панельки под микросхемы, PGA, с нулевым усилением

PGZP

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово или золото
поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

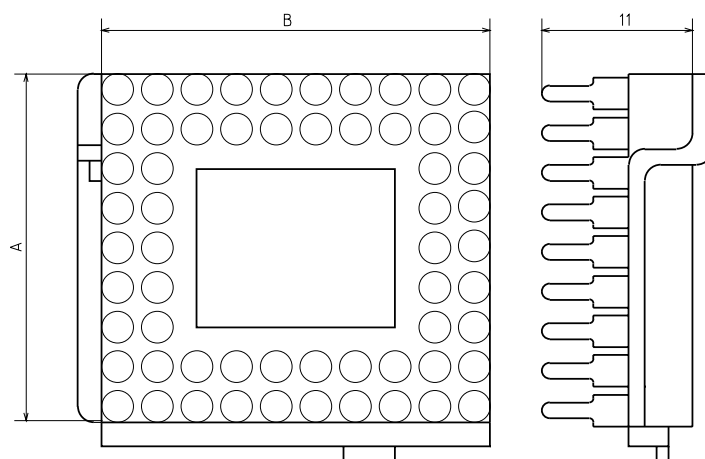
Сопротивление контактов: не более 2×10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Усилие сочленения: не более 140 гр.

Усилие расчленения: не менее 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до +105°C



PGZP-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	кол-во контактов	A	B
PGZP-237	237	62.5	52.5
PGZP-238	238	67.0	57.5

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Панельки под микросхемы, DIMM

DIMM

Материал

Контакты: фосф.бронза, олово поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Рабочее напряжение: 250 В

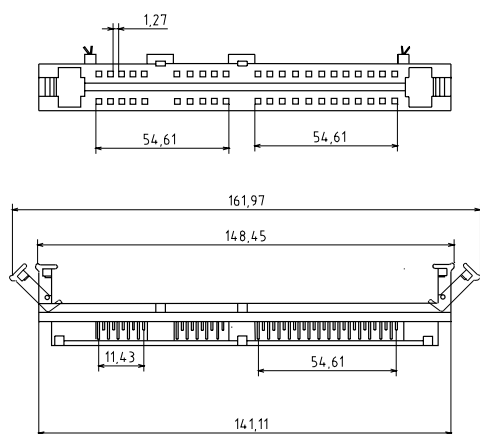
Предельное напряжение: 1000 В в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
при 500 В DC

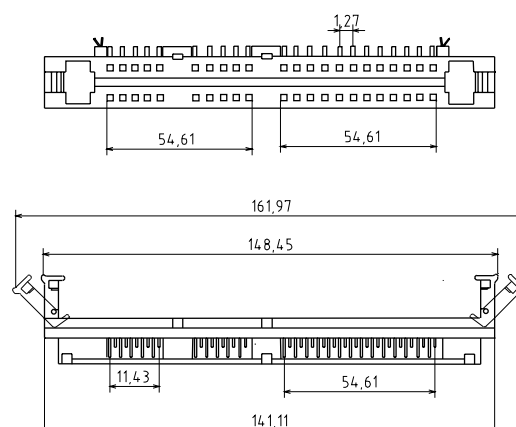
Сопротивление контактов: не более 10^{-2} Ом
для олова; не более 10^{-2} Ом для золота

Эксплуатационные характеристики

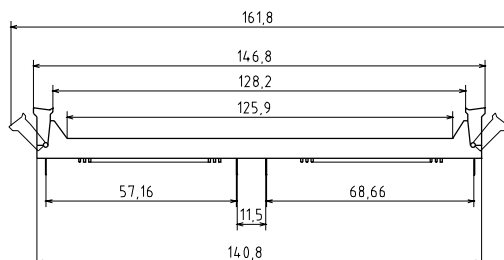
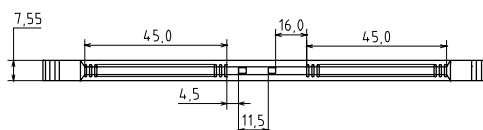
Допустимые температуры: от -55 до +105°C



DIMM-168



DIMM-168N



DIMM-184